

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-307273

(43)Date of publication of application : 28.11.1997

(51)Int.Cl.

H05K 9/00

(21)Application number : 08-118828

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 14.05.1996

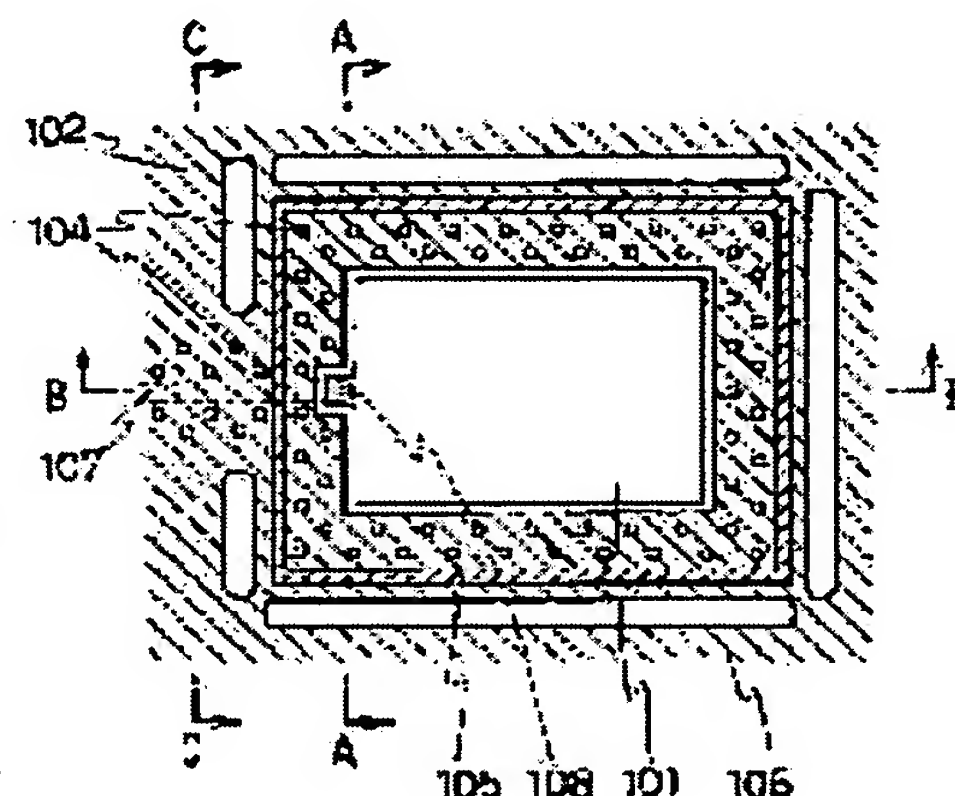
(72)Inventor : SERIZAWA NORIKAZU
ADACHI HISASHI
KOSUGI HIROAKI
SUEYOSHI TATSUYA

(54) HIGH-FREQUENCY CIRCUIT IN SHIELDING STRUCTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-frequency circuit in shielding structure for effectively shielding a high-frequency circuit and a signal line on a substrate from the electromagnetic waves propagating in the air and on the substrate using multilayer substrate.

SOLUTION: A high-frequency circuit 101 and a ground pattern encircling the circuit 101 is composed on the surface layer of multilayer substrate so as to form a ground layer on the inner layer beneath the high-frequency circuit 101 and a ground pattern 102. Besides, a shielding case 105 encircling the upper part and the side of the high-frequency circuit 101 and grounding to the ground pattern 102 is also provided while a plurality of via holes 104 connecting to the ground pattern 102 and the ground layer is provided around the high-frequency circuit 101. A signal line 107 of the high-frequency circuit positioned on the inner layer is held by the ground pattern 102 and the ground layer while the plurality of via holes 104 are positioned on both sides of the signal line 107.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DP-948 US

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-307273

(43) 公開日 平成9年(1997)11月28日

(51) Int.Cl.⁹

H05K 9/00

識別記号

庁内整理番号

FI

H05K 9/00

技術表示箇所

R

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号

特願平8-118828

(22) 出願日

平成8年(1996)5月14日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 芹澤 純和

横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 松下
通信工業株式会社内

(72) 発明者 足立 寿史

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 小杉 裕昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 池内 寛幸 (外1名)

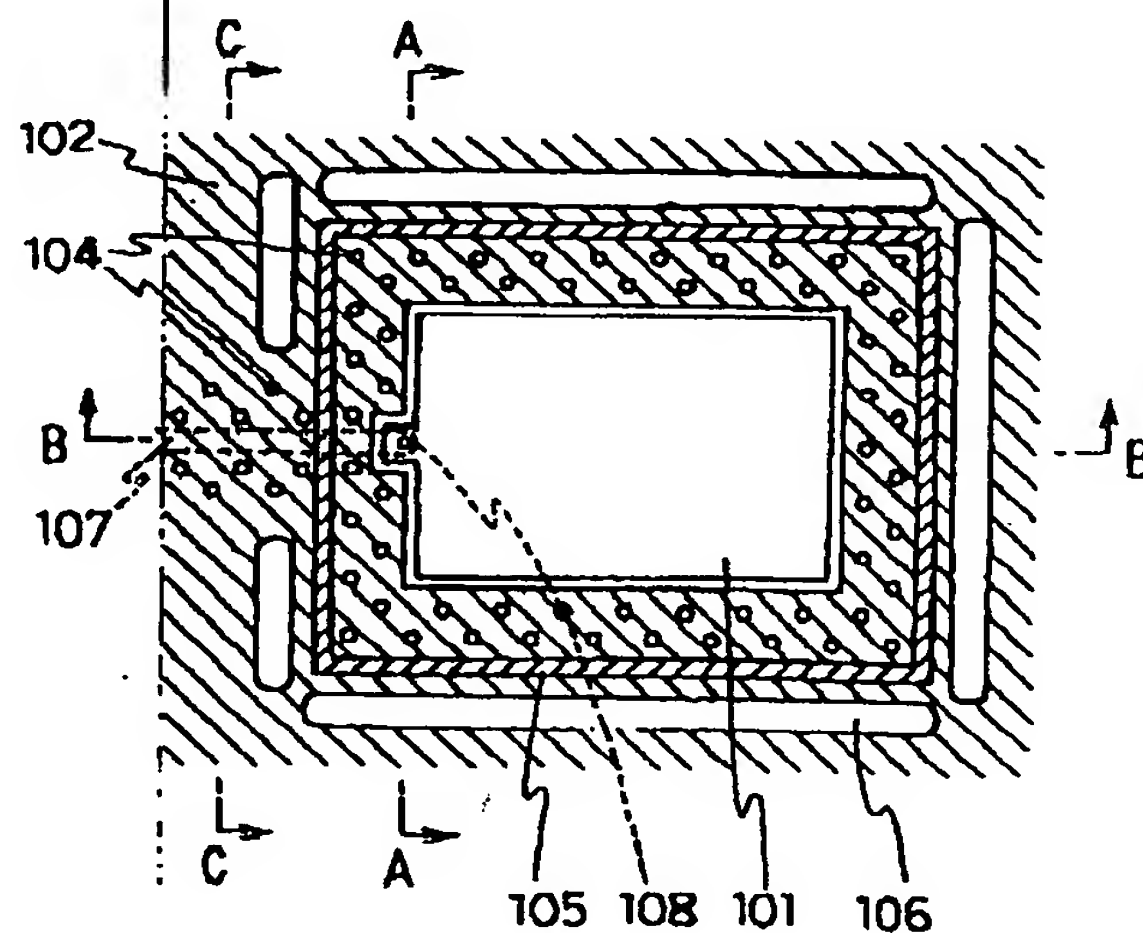
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シールド構造を備えた高周波回路

(57) 【要約】

【課題】 多層基板を有効に用いて、基板上の高周波回路及び信号線を、空間及び基板内を伝搬する電磁波から効果的に遮蔽するシールド構造を備えた高周波回路を提供する

【解決手段】 多層基板の表層に高周波回路101及びこれを囲むグラウンドパターン102が構成され、高周波回路101及びグラウンドパターン102下の内層または裏面にグラウンド層103が形成されている。高周波回路101の上方及び側方を囲みグラウンドパターン102に接地するシールドケース105を備え、高周波回路101の周囲にはグラウンドパターン102及びグラウンド層103を接続する複数のビアホール104が設けられている。高周波回路の信号線107は基板の内層に位置してグラウンドパターン102及びグラウンド層103に挟まれ、その両側には複数のビアホール104が位置する。



BEST AVAILABLE COPY

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 多層基板の表層に構成された高周波回路と、この高周波回路を囲む表層のグラウンドパターンと、前記高周波回路及びグラウンドパターンの下の内層または裏面に形成されたグラウンド層と、前記グラウンドパターンに接地して前記高周波回路の上方及び側方を囲むシールドケースと、前記グラウンドパターンおよびグラウンド層を接続する複数のビアホールとを備え、

前記高周波回路に接続する信号線は前記多層基板の内層に位置して前記グラウンドパターンおよびグラウンド層に挟まれ、

さらに、前記信号線の両側に前記グラウンドパターンおよびグラウンド層を接続する複数のビアホールが位置していることを特徴とするシールド構造を備えた高周波回路。

【請求項2】 前記高周波回路の周囲及び前記高周波回路に接続する信号線の両側に位置するビアホールの外側に、前記多層基板の表裏を貫くスリットが設けられている請求項1記載のシールド構造を備えた高周波回路。

【請求項3】 前記グラウンドパターン、グラウンド層、シールドケース、およびビアホールによって囲まれた高周波回路を複数備え、前記複数の高周波回路を接続する信号線は多層基板の内層に位置して前記グラウンドパターンおよびグラウンド層に挟まれ、前記信号線の両側に前記グラウンドパターンおよびグラウンド層を接続する複数のビアホールが位置している請求項1または2記載のシールド構造を備えた高周波回路。

【請求項4】 前記複数の高周波回路のうち少なくとも一つは発振回路を含んでいる請求項3記載のシールド構造を備えた高周波回路。

【請求項5】 発振回路を含む複数の高周波回路と、スイッチ回路を含む高周波回路とを備え、前記複数の発振回路は同一または近接した周波数で発振し、前記スイッチ回路は前記発振回路のいずれかの出力を選択して出力する請求項4記載のシールド構造を備えた高周波回路。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明属する技術分野】本発明は、主として多層基板上の高周波回路及びその信号線を、周辺空間及び基板内を伝搬する電磁波から遮蔽するためのシールド構造を備えた高周波回路に関する。

【0002】

【従来の技術】高周波回路を遮蔽する場合、高周波回路の周囲にある基板表層のグラウンドパターンに接地したシールドケースによって、空間を伝搬する電磁波から高周波回路を遮蔽をすることがよく行われる。従来のシールド構造を備えた高周波回路の一例を図6及び7に示す。図6は平面図であり、図7は斜視図（外観図）である。これらの図において、601は基板表層に形成された遮蔽されるべき高周波回路であり、602は高周波回路601の周囲に形成された基板表層のグラウンドパターンで

(2)

特開平9-307273

2

ある。603は、高周波回路601の上方及び側方を囲むシールドケースであり、グラウンドパターン602に接地している。但し、図6の平面図においてシールドケース603は天面を除いた側壁だけが描かれている。604は高周波回路601の入力信号線、605は高周波回路601の出力信号線である。606は基板裏面にあるグラウンド層である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のような構成では、信号線を通すためにシールドケース603に開口部を設ける必要があり、シールドケース603の効果が弱まるという問題点がある。特に、高周波回路601の入出力線である信号線604、605は遮蔽されていない。また基板内部は遮蔽されていないので高周波回路601の遮蔽効果も小さい。

【0004】本発明は上記問題点に鑑み、基板上の高周波回路及び信号線を、空間を伝搬する電磁波だけでなく基板内を伝搬する電磁波からも効果的に遮蔽するシールド構造を備えた高周波回路を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明によるシールド構造を備えた高周波回路は、高周波回路の周囲に表層のグラウンドパターンを備え、高周波回路及びグラウンドパターンの下の内層または裏面にグラウンド層を備えている。そして高周波回路の上方および側方を囲みグラウンドパターンに接地しているシールドケースと、前記グラウンドパターン及びグラウンド層を接続する複数のビアホールとが設けられている。また高周波回路に接続する信号線は多層基板の内層に位置してグラウンドパターンとグラウンド層とに挟まれ、その両側にはグラウンドパターンおよびグラウンド層を接続するビアホールが位置している。

【0006】このような構造を備えた高周波回路は、シールドケースによって、空間を伝搬する電磁波から遮蔽されると共に、グラウンドパターン、グラウンド層、及びこれらを接続する複数のビアホールによって、基板内を伝搬する電磁波からも遮蔽される。また、信号線を基板の内層に通すことにより、シールドケースに囲まれた高周波回路とシールドケース外部とを、シールドケースに開口部を設けることなく信号線で接続することができる。そして、信号線は、上側のグラウンドパターン、下側のグラウンド層、および両側のビアホールによって効果的に遮蔽される。

【0007】さらに、前記高周波回路の周囲及び前記高周波回路に接続する信号線の両側に位置するビアホールの外側に、前記多層基板の表裏を貫くスリットが設けられていることが好ましい。このスリットの働きによって、高周波回路およびその信号線を基板の他の部分から遮蔽する効果が高められる。

3

【0008】上記のような高周波回路を複数備えた構成にも本発明を適用することができ、この場合、複数の高周波回路を接続する信号線は多層基板の内層に位置して前記グラウンドパターンおよびグラウンド層に挟まれ、前記信号線の両側に前記グラウンドパターンおよびグラウンド層を接続する複数のビアホールが位置することになる。なお、複数の高周波回路のうち少なくとも一つが発振回路を含んでいる場合に本発明を適用する効果が高い。例えば、発振回路を含む複数の高周波回路と、スイッチ回路を含む高周波回路とを備え、前記複数の発振回路は同一または近接した周波数で発振し、前記スイッチ回路が前記発振回路のいずれかの出力を選択して出力するような構成に本発明を適用することが好ましい。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明の第1の実施形態に係るシールド構造を備えた高周波回路の構造を示す平面図である。また、図2は図1のA-A断面図、図3は同じくB-B断面図、そして図4は同じくC-C断面図である。

【0010】図1～4において、101は多層基板の表層に形成された高周波回路である。102は高周波回路101の周囲に設けられた表層のグラウンドパターン、103は高周波回路101及びグラウンドパターン102の下に位置する内層及び裏層のグラウンド層、104はグラウンドパターン102とグラウンド層103を接続しているビアホールである。105はシールドケースで高周波回路101の上部を覆い、グラウンドパターン102に接地している。106は基板の表裏を貫くスリットである。107は高周波回路101の出力信号線であり、基板の内層を通っている。108は高周波回路101と出力信号線107を接続するビアホールである。

【0011】高周波回路101は、シールドケース105により、空間を伝搬する電磁波から遮蔽されている。また、グラウンドパターン102、グラウンド層103、ビアホール104により、高周波回路101は基板内部を伝搬する電磁波からも遮蔽されている。出力信号線107は、シールドケース105の内外に設けられたビアホール104とグラウンドパターン102とグラウンド層103とにより空間及び基板内部を伝搬する電磁波から遮蔽されている。またスリット106により、高周波回路101及び出力信号線107が基板の他の部分から分離され、遮蔽効果を高めている。

【0012】以上のように本実施形態によれば、グラウンドパターン102、グラウンド層103、ビアホール104により基板内に接地面の壁を作り、シールドケース105により高周波回路101の上面及び側面を覆うことで、高周波回路101の周囲を全面グラウンドで囲むことができる。また、ビアホール104の外側にスリット106を設けることにより、高周波回路101及び出力信

(3)

特開平9-307273

4

号線107を基板の他の外部回路と分離することができる。これにより高周波回路101及び出力信号線107に対し高い遮蔽効果を実現する。また、信号線が基板の内層を通っていることにより、従来のように信号線を通すための開口部をシールドケースに設ける必要もなくなり、シールドケースによるシールド効果の低下を防ぐことができる。

【0013】次に、本発明の第2の実施形態に係るシールド構造を備えた高周波回路を図5に示す。この実施形態における高周波回路は二つの周波数シンセサイザを含み、二つの周波数シンセサイザが発生する二つの信号のうち一方をスイッチ回路によって選択して出力するといった動作を行う。

【0014】この高周波回路が構成される多層基板は、図1～4で説明した第1の実施形態と同様の構造のものである。図5において、501、502、および503は基板の表層のグラウンドパターンと内層のグラウンド層とを接続するビアホール、504、505、および506はシールドケース、507はスリットであり、これらは図1のビアホール104、シールドケース105、スリット106と同様のものである。508および509は発振回路を含む周波数シンセサイザであり、それぞれが同一または近接した周波数で発振する。510は周波数シンセサイザ508、509のいずれかを信号を選択して出力するスイッチ回路である。511および512は周波数シンセサイザ508、509とスイッチ回路510とを接続する信号線、513はスイッチ回路510の出力信号線である。514は信号線511、512と周波数シンセサイザとを接続するビアホールであり、515は信号線511、512、513とスイッチ回路とを接続するビアホールである。

【0015】このようなシールド構造を備えた高周波回路において、ビアホール501、502、503、シールドケース504、505、506、そしてスリット507によって得られる効果は第一の実施形態のビアホール104、シールドケース105、およびスリット106によって得られる効果と同様である。周波数シンセサイザ508、509のそれぞれが各別のシールド構造を備えていることにより、スイッチ回路510で選択された側の周波数シンセサイザの出力信号を非選択側の周波数シンセサイザ及びその出力信号線から遮蔽することができる。また、スイッチ回路510にもシールド構造を備えさせたことにより、スイッチ510回路の出力部及びスイッチの出力信号線513を非選択側の周波数シンセサイザの出力信号から遮蔽することができる。

【0016】本実施形態のように、複数の高周波回路のそれぞれがシールド構造を備えた高周波回路であることにより、それぞれの高周波回路を他の高周波回路の信号から遮蔽することができる。

【0017】なお、上記の第1および第2の実施形態に

5

において、高周波回路の信号線として、高周波信号の信号線のみを記載したが、制御信号の信号線や直流電源線についても、同様の構造によってシールド効果が得られる。

【0018】また、高周波回路及び基板表層のグランドパターンの下に位置するグランド層は、基板内層及び裏面の層のうち、少なくとも一層に形成されておればよい。

【0019】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、多層基板上の高周波回路及びその信号線を囲む基板の表層のグランドパターン、基板の内層または裏面のグランド層、及びグランドパターンとグランド層とを接合するビアホールにより基板内を伝搬する電磁波から高周波回路を遮蔽することができ、高周波回路の上方及び側方を囲みグランドパターンに接地しているシールドケースにより、空間を伝搬する電磁波から高周波回路を遮蔽することができる。また基板の表裏を貫くスリットを設けることにより高周波回路と他の部分との分離をより確実なものとすることができる。

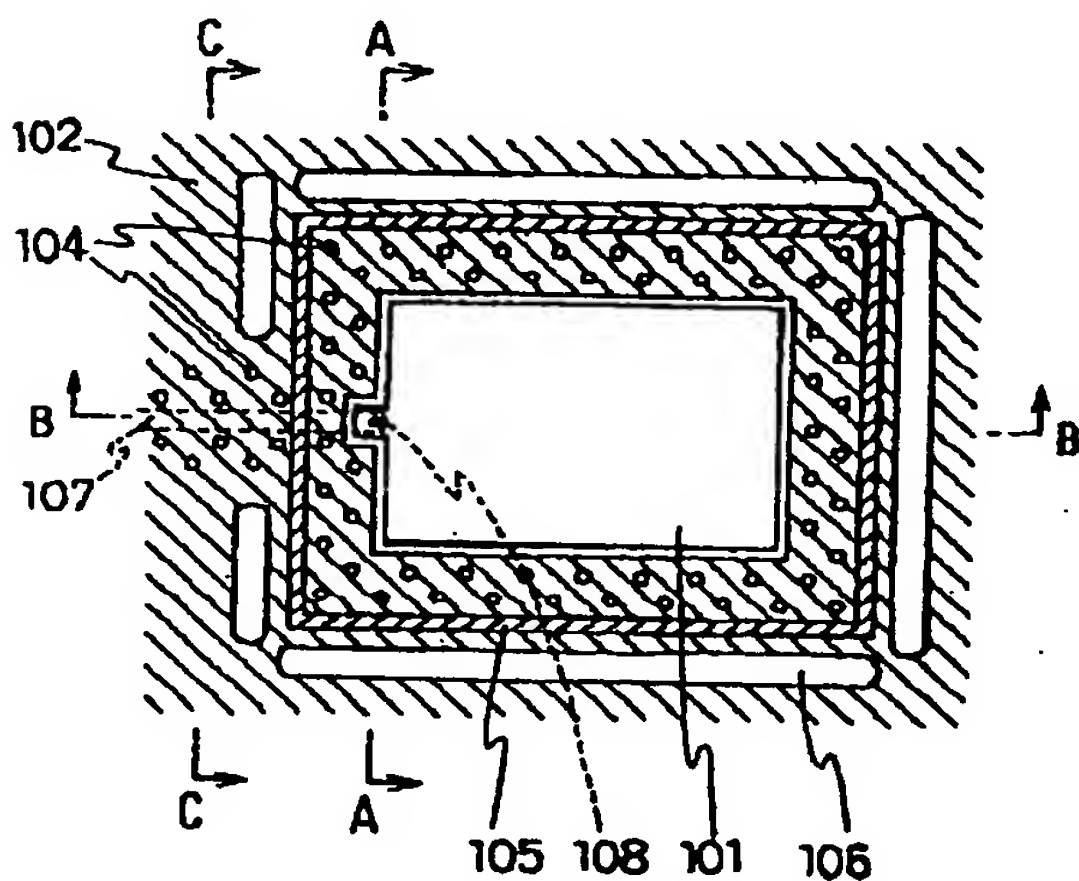
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係るシールド構造を備えた高周波回路の平面概略構成図

【図2】図1の高周波回路のA-A断面図

【図3】図1の高周波回路のB-B断面図

【図1】



(4)

特開平9-307273

6

【図4】図1の高周波回路のC-C断面図

【図5】本発明の第2の実施形態に係るシールド構造を備えた高周波回路の平面概略構成図

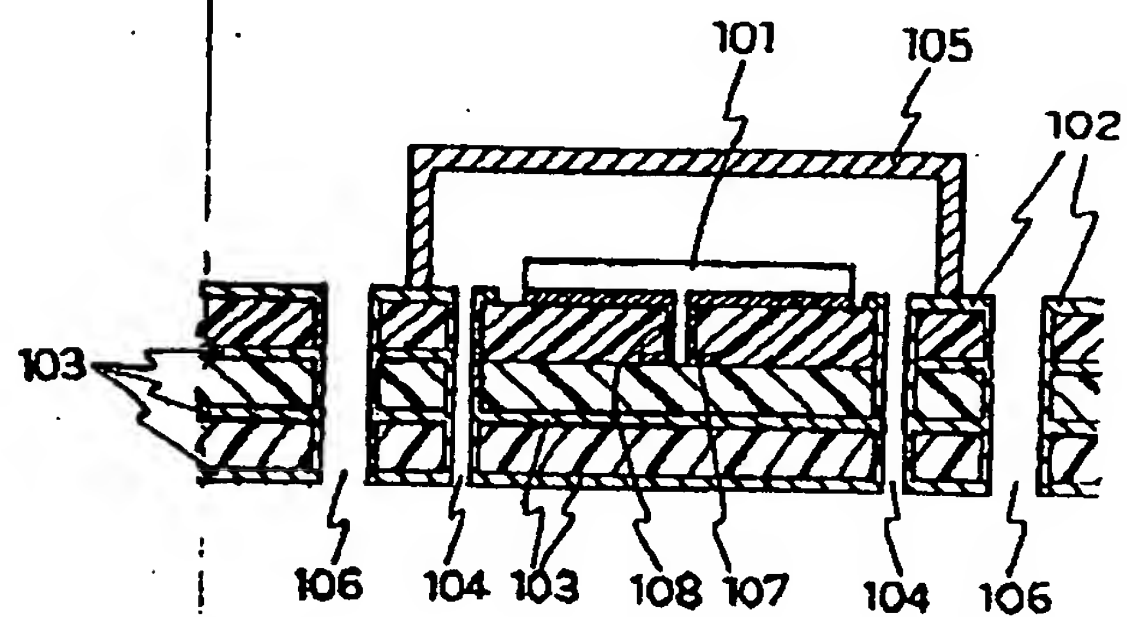
【図6】従来のシールド構造を備えた高周波回路の平面概略構成図

【図7】図6の高周波回路の斜視図

【符号の説明】

- | | |
|-----|-----------------------|
| 101 | 高周波回路 |
| 102 | グランドパターン |
| 103 | グランド層 |
| 104 | 501, 502, 503 ビアホール |
| 105 | 604, 605, 606 シールドケース |
| 106 | 507 スリット |
| 107 | 出力信号線 |
| 108 | ビアホール |
| 508 | 509 周波数シンセサイザ |
| 510 | 選択スイッチ回路 |
| 511 | 512, 513 信号線 |
| 514 | 515 ビアホール |
| 20 | 601 高周波回路 |
| | 602 グランドパターン |
| | 603 シールドケース |
| | 604 入力信号線 |
| | 605 出力信号線 |
| | 606 グランド層 |

【図2】

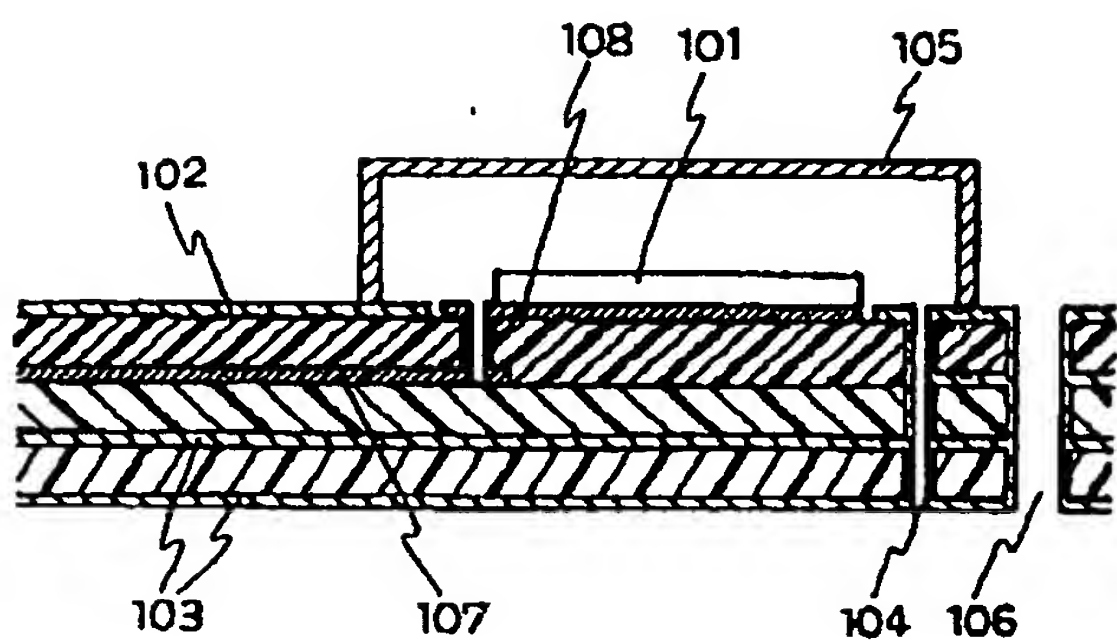


BEST AVAILABLE COPY

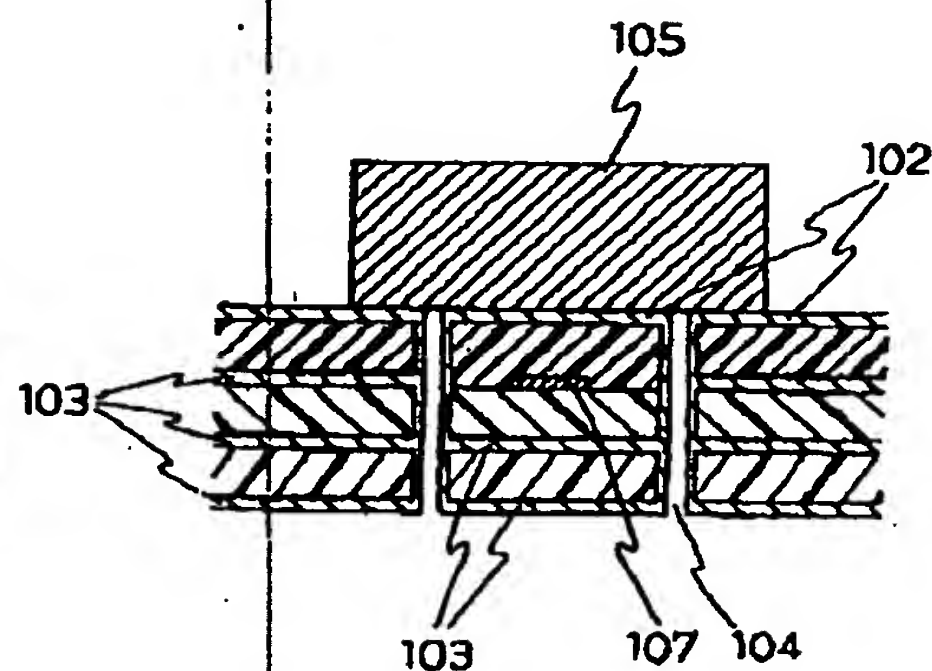
(5)

特開平9-307273

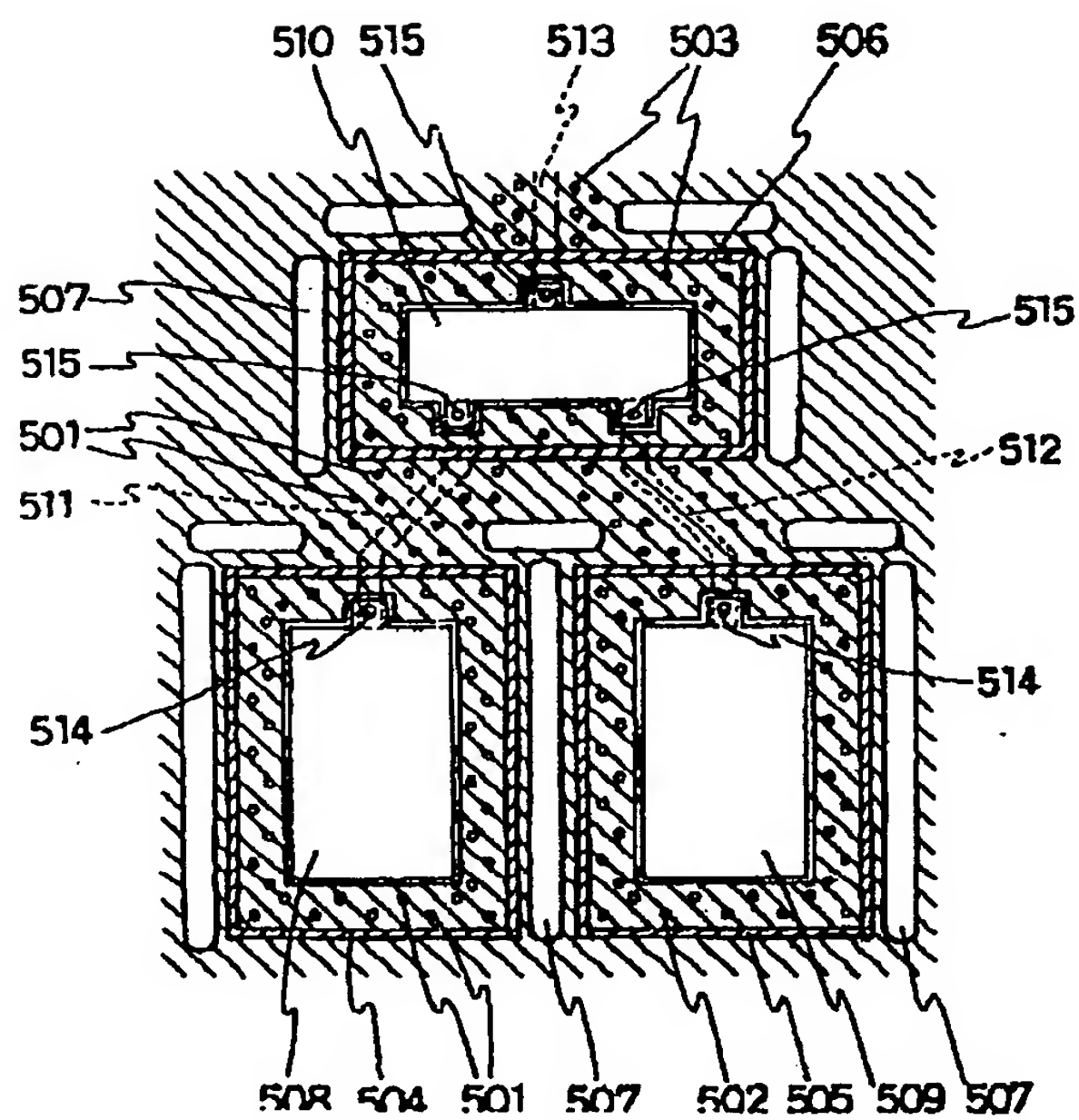
【図3】



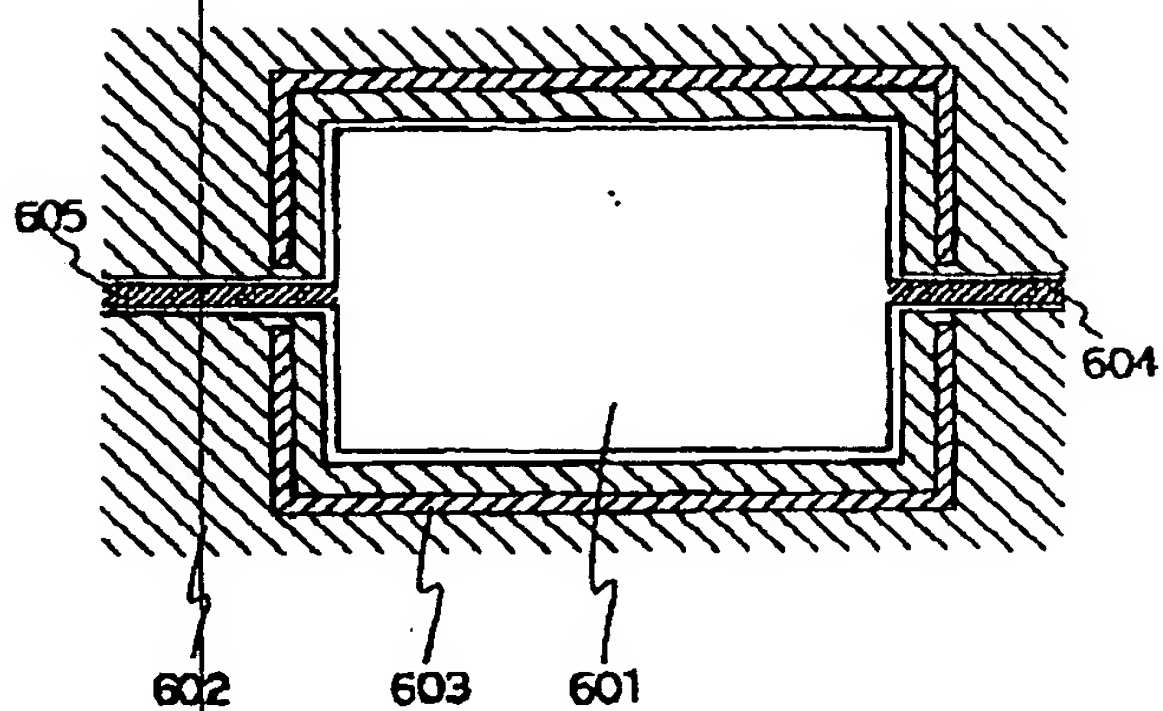
【図4】



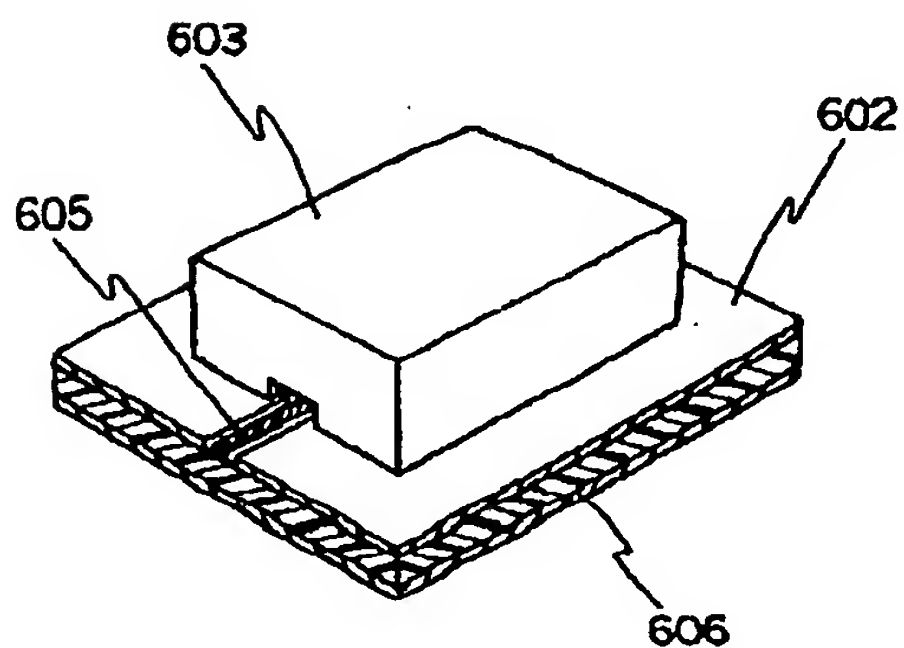
【図5】



【図6】



【図7】



(6)

特開平9-307273

フロントページの続き

(72)発明者 末吉 達也

横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 松下
通信工業株式会社内



BEST AVAILABLE COPY